

アルミベース銅張積層板 Aluminum Based materials for PCB ALC-1331

特徴

- ・高熱伝導(絶縁層部分の熱伝導率 3W/mK)
- ・低熱抵抗
- ・ハロゲンフリー材
- ・耐トラッキング性CTI値600V
- ・高耐電圧
- ・1×3mの大型サイズにて生産

用途

- ・LED照明
- ・液晶テレビLEDバックライト

Features

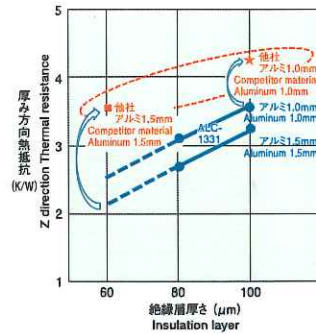
- ・High Thermal conductivity (3W/mK Part of Insulation Layer)
- ・Low Thermal resistance
- ・Halogen Free material
- ・Anti Tracking material CTI 600V<
- ・High Withstand Voltage
- ・Original Production Size 1x3meter

Application

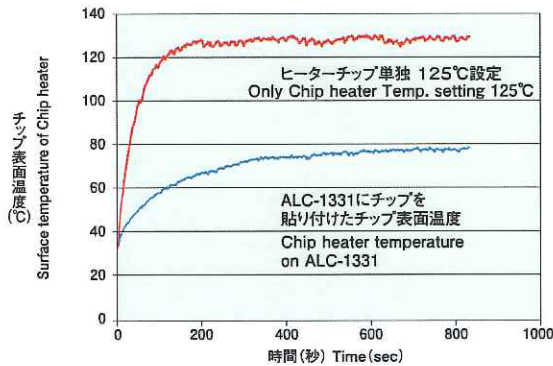
- ・LED Lighting
- ・LCD TV (LED Back Light)

熱抵抗 Thermal resistance

品番 Item	構成 Composition			厚み方向 Z direction 熱抵抗 Thermal resistance K/W
	アルミ Aluminum mm	絶縁層 Insulation Layer μm	銅箔 Copper μm	
ALC-1331	1.0	80	35	3.10
	1.0	100	35	3.51
	1.5	80	35	2.77
	1.5	100	35	3.19



チップヒーターの放熱性評価 Temperature of Chip heater on ALC-1331



基板サイズ : 25mm×25mm

構成 : 80μ絶縁層 / 1mmアルミ板

Specimen size : 25mm×25mm

Composition : 80μ Insulation layer / 1mm Aluminum base

試料は吊下げて測定

Test piece : hangs and measures.

125°Cに発熱するチップ部品を80°C以下に放熱。

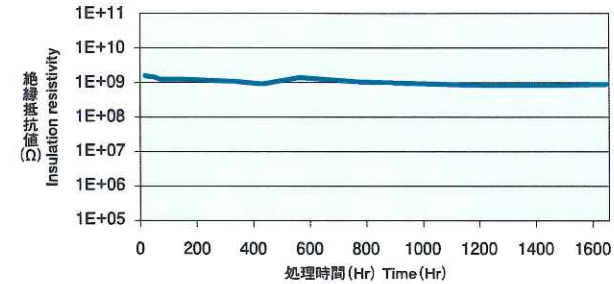
Temp. of Chip heater on ALC-1331 reduced from 125°C to below 80°C

連続温中 層間絶縁評価

絶縁層厚: 80μm 銅箔: 35μm アルミ板: 1mm
測定方法: 85°C/85%RH/DC50V印加 温中連続測定(測定電圧100V)

Interlayer Insulation resistance

Insulation Layer: 80μm Copper: 35μm Aluminu: 1mm
Test condition: 85°C / 85%RH / DC50V (Testing Voltage 100V)

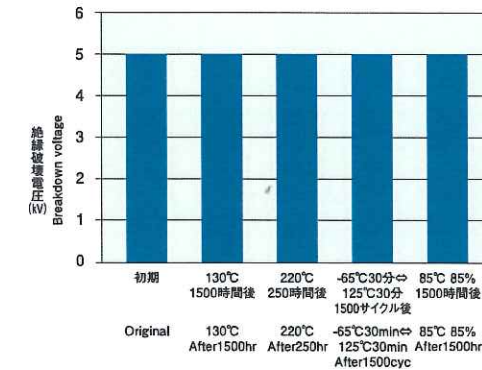


絶縁破壊電圧 (AC)

絶縁層厚: 80μm 銅箔: 35μm アルミ板: 1mm
測定方法: AC耐電圧測定 0.5kV/秒 連続昇圧

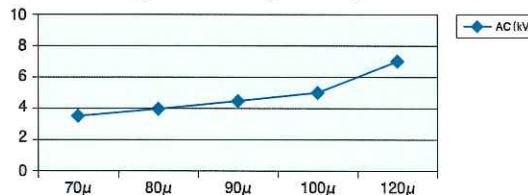
Breakdown Voltage

Insulation Layer: 80μm Copper: 35μm Aluminu: 1mm
Test condition: AC 0.5kV/sec Continuous voltage rise



初期状態実力値を維持している結果であり、上記処理による絶縁層劣化は見られない。
Withstand Voltage doesn't change even after heat or heat and moisture treatment

70~120μm 層間耐電圧 Withstand voltage Insulation Layer 70~120μm



測定方法: AC 0.5kV/60sec保持 ステップ昇圧
Test condition: AC 0.5kV/60sec keep Step voltage rising